

# レーザースルーホールフィリング用 硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating to Fill Laser Through-hole

## トップルチナLTF

TOP LUCINA LTF

- 低膜厚でスルーホールフィリングを実現  
Realize through-hole filling by thin thickness
- 低膜厚化によって配線の微細化に対応  
Applicable to micro-patterning by thin thickness
- コア基板形成の工程簡略化が可能  
Can reduce treatment steps by forming core substrates
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能  
Quantitative analysis is possible for all additives

### 低膜厚でスルーホールフィリングを実現 Realize through-hole filling by thin thickness

硫酸銅五水和物 CuSO <sub>4</sub> ·5H <sub>2</sub> O	硫酸 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	塩化物イオン Cl <sup>-</sup>	電流密度 Current density	めっき膜厚 Film thickness
230g/L	70g/L	30mg/L	1.0A/dm <sup>2</sup>	15μm

